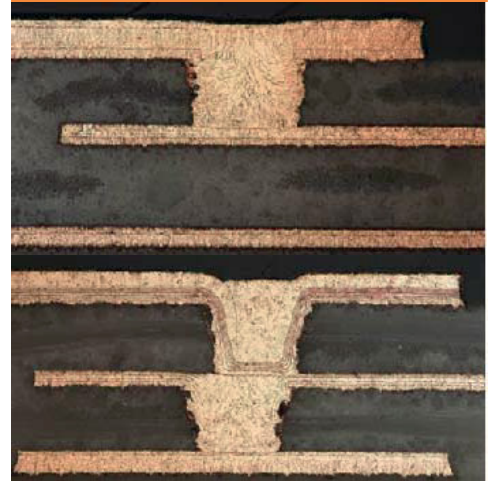


CU4000™ 和CU4000 LoPro® 电解铜箔数据资料表

罗杰斯的CU4000™铜箔专用于RO4000®半固化片的铜箔压合工艺，与RO4000芯板搭配设计多层板。CU4000是一款高性能的单面处理的电解铜箔，其增加的机械粘接面积使在RO4400™系列半固化片材料上具有更高的剥离强度。CU4000 LoPro®是反转处理电解铜箔，其采用一层非常薄的粘合层以加强光滑铜箔与介质间的结合力，同时较高频率下能够降低电路损耗。这一薄的粘合层使材料厚度增加约0.00035”。在用于铜箔压层多层板结构时，当用CU4000与CU4000 LoPro铜箔压合多层板工艺时，能够降低多层板对准度和填充的要求。

罗杰斯的CU4000和CU4000 LoPro是IPC-4562 中等级3的高温高延伸性铜箔。

数据资料表



特性与优势：

- 可用铜箔压合工艺制作RO4000多层板直接使用
- 在RO4400系列半固化片上具有出众的结和力
- 降低半固化片材料的填充要求
- 降低多层板对准度
- 可用于高密度互连（HDI）和增层工艺

性能指标	典型值 ^[1]				单位	条件	测试方法
	CU4000 ED		CU4000 LoPro				
标称厚度	18	35	18	35	μm	-	-
面积权重	1/2	1	1/2	1	oz/ft ²	-	-
拉伸强度	48	48	62	58	kpsi	RT	IPC-TM-650, 2.4.18B
	26	26	33	34		180°C	
延伸率	10	14	10	16	%	RT	IPC-TM-650, 2.4.18B
	7	7	8	8		180°C	
粗糙度 (Rz)	7-10	8-13	2-3	2-3	μm	粗糙面	IPC-TM-650 2.2.17

^[1] 典型值表示通常产品性能指标的平均数值。如果对参数有特殊要求，请联系罗杰斯公司。

铜箔类型：	兼容的半固化片：
CU4000电解铜箔和CU4000 LoPro铜箔	RO4450B™, RO4450F, RO4450T™, RO4460G2™

标准厚度：	标准尺寸：
18μm (1/2 oz) 35μm (1 oz)	24.5X18.5英寸 (622X470毫米) CU4000：数量为100张的整数倍 CU4000 LoPro：数量为25张的整数倍

本数据资料表中所包含的信息旨在协助您采用罗杰斯的线路板材和半固化片进行的设计，无意且不构成任何明示的或隐含的担保，包括对商品适用性、适用于特别目的等任何担保，亦不保证用户可在特定用途达到本数据表及加工说明中显示的结果。用户应负责确定罗杰斯线路板材材料和半固化片在每种应用中的适用性。

相关产品、技术和软件根据出口规定出口自美国，禁止违反美国法律。

罗杰斯标识、RO4000、RO4400、RO4450B、RO4450F、RO4450T、RO4460G2、CU4000、LoPro、Helping power, protect, connect our world和LoPro均为罗杰斯公司（Rogers Corporation）或其子公司的注册商标。

© 2018年罗杰斯公司版权所有，保留所有权利。中国印刷。

发布于 1210 032618 版本号 #92-176CS